

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

### 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-09-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	国泰君安电子行业首席分析师 王聪，分析师 苏凌瑶、舒迪、郭航； 东北证券电子组首席分析师 李玖，分析师 武芄睿； 国信证券电子行业分析师 胡慧、胡剑； 中泰证券电子行业分析师 张欣； 安信证券电子行业分析师 郭旺； 交银施罗德电子行业首席分析师 高扬，投资经理 孙婕衍； 兴证全球基金研究员 涂围； 银华基金 郭磊、杜宇； 永赢基金 张世杰； 淳厚基金 吴若宗； 浦银安盛基金 朱胜波、郑敏宏； 诺德基金 王优草； 惠升基金 彭柏文。
时间	2021年9月27日、9月28日
地点	公司会议室（现场+网络电话）
上市公司接	副总经理/董事会秘书 李志萍

待人姓名	
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司主营业务为半导体硅材料、高压器件的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒、半导体单晶硅片、高压器件，应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料及高压器件制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。在我国分立器件用硅研磨片领域占据领先的市场地位，在高压器件产品中占据龙头地位。最终产品应用在各种电子产品当中，包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。</p> <p>二、互动交流</p> <p><b>1、公司当前的经营情况如何？</b></p> <p>目前公司经营状况良好，订单稳定。具体情况请关注公司后续定期报告。</p> <p><b>2、公司目前研磨片产品的扩产情况如何？募投项目和高压器件项目进展如何吗？</b></p> <p>截至目前，各个项目均进展顺利。宁夏资产收购项目的设备改造升级后逐步投入使用，硅棒的产量已逐步释放，浙江中晶、西安中晶的硅片产能也在逐步扩产中；募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》的基础设施建设、公共动力设施、管道安装、设备到货等按照整体规划在加速推进中；高压器件产品由控股子公司江苏皋鑫为主体实施，当前江苏皋鑫已基本完成南通皋鑫相关业务的承接，并在进一步上量扩产中。</p>

**3、原材料涨价后，公司的毛利率稳中有升，请问主要原因是什么？**

(1) 公司建有行业最大规模的半导体磁场单晶生长炉台，以及硅片加工和测试工艺制程，生产能力和技术水平处于领先地位，规模效应提高了产品利用率，从而提高产品的经济效益；

(2) 生产基地的资源有效划分配置，根据各个子公司所处的优势进行产业配置，有针对性的开展相应业务，既有效利用各地资源，也节约了生产成本；

(3) 通过提高产品良率、改进生产工艺、加强设备自动化改造、增加技术研发投入等方式，不断提高产品生产效率及质量水平；

(4) 公司经营注重时间成本和原料储备等因素的有效控制，细节把控各项因素对公司生产经营的影响。

**4、公司今年年底或者明年年初会有涨价的计划吗？原材料价格降低的话，公司会同步降价吗？**

公司产品价格定价将参照市场环境和成本因素综合考量。

**5、公司当前的产品布局如何？未来主营业务将如何安排？**

公司目前的产品布局主要有以下方面：3-6英寸硅研磨片，且该业务已在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；募投项目以全资子公司浙江中晶新材料有限公司为实施主体的《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》当前在加速推进中；公司与如皋工业园区管理委员会签署投资协议，以公司控股子公司江苏皋鑫电子有限公司为实施主体进行《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》，正在履行相关程序，项目总投资不低于10亿元。公司未来将深耕半导体硅材料领域，根据公司业务发展战略，不断提高公司主营业务的发展实力及产品影响力，提升公司经营业绩。

附件清单(如有)	无
日期	2021年9月27日、9月28日